日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 2月24日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-046318

[ST. 10/C]:

Applicant(s):

[J P 2 0 0 3 - 0 4 6 3 1 8]

出 願 人

ソニー株式会社

2003年10月27日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office





【書類名】 特許願

【整理番号】 0390032502

【提出日】 平成15年 2月24日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05B 33/00

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】 岩瀬 祐一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】 浅野 慎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社

内

【氏名】 平野 貴之

【特許出願人】

【識別番号】 000002185

【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100098785

【弁理士】

【氏名又は名称】 藤島 洋一郎

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 019482

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9708092

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 表示装置およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板と、

- この基板に設けられた駆動素子層と、
- この駆動素子層を覆う平坦化層と、
- この平坦化層の前記基板と反対側に設けられた複数の発光素子と、
- この複数の発光素子を覆うと共に前記平坦化層の表面および端面を覆う中間層と、

この中間層を介して前記基板の前記発光素子側に対向配置された封止基板とを備えたことを特徴とする表示装置。

【請求項2】 前記平坦化層は、有機材料により構成されている

ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。

【請求項3】 前記平坦化層は、周辺回路部をも覆っている

ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。

【請求項4】 前記中間層は、

前記発光素子ならびに前記平坦化層の表面および端面を覆う保護膜と、

この保護膜と前記封止基板との間に設けられ、前記基板と前記封止基板とを全面にわたって貼り合わせる接着層と

を含むことを特徴とする請求項1記載の表示装置。

【請求項5】 前記中間層は、前記基板と前記封止基板とを全面にわたって 貼り合わせるための接着層である

ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。

【請求項6】 前記発光素子は、前記基板に、第1電極と第2電極との間に 発光層を含む有機層を前記基板の側から順に積層した構成を有し、前記発光層で 発生した光を前記第2電極の側から取り出す有機発光素子である

ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。

【請求項7】 前記発光素子は、前記第2電極の電圧降下を抑制するための 補助電極を前記平坦化層に接して有している ことを特徴とする請求項6記載の表示装置。

【請求項8】 基板に駆動素子層を形成する工程と、

前記駆動素子層を覆う平坦化層を形成する工程と、

前記平坦化層の上に複数の発光素子を形成する工程と、

前記発光素子ならびに前記平坦化層の表面および端面を覆う中間層を形成する 工程と、

前記中間層の上に封止基板を配設する工程と

を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。

【請求項9】 前記平坦化層を形成する工程において、前記平坦化層として 予め用意したシート状平坦化膜を配置する

ことを特徴とする請求項8記載の表示装置の製造方法。

【請求項10】 前記平坦化層を形成する工程において、感光性を有する材料よりなる感光性膜を形成し、前記感光性膜の露光および現像により前記平坦化層を形成する

ことを特徴とする請求項8記載の表示装置の製造方法。

【請求項11】 前記中間層を形成する工程において、前記発光素子ならびに前記平坦化層の表面および端面を覆う保護膜を形成したのち、前記基板と前記封止基板とを接着層を介して全面にわたって貼り合わせる

ことを特徴とする請求項8記載の表示装置の製造方法。

【請求項12】 前記発光素子として、前記基板に、第1電極と第2電極との間に発光層を含む有機層を前記基板の側から順に積層した構成を有し、前記発光層で発生した光を前記第2電極の側から取り出す有機発光素子を設ける

ことを特徴とする請求項8記載の表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、発光素子を有する基板と封止基板とを中間層を介して対向配置した 表示装置およびその製造方法に係り、特に上面発光の有機発光素子を用いた有機 発光ディスプレイに好適な表示装置およびその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

近年、液晶ディスプレイに代わる表示装置として、有機発光素子を用いた有機発光ディスプレイが注目されている。有機発光ディスプレイは、自発光型であるので視野角が広く、消費電力が低いという特性を有し、また、高精細度の高速ビデオ信号に対しても十分な応答性を有するものと考えられており、実用化に向けて開発が進められている。

[0003]

有機発光ディスプレイでは、例えば、基板の上に、TFT(Thin Film Transi stor;薄膜トランジスタ)などの駆動素子が形成され、この駆動素子の上に、平坦化層を介して有機発光素子が形成されている。平坦化層は、駆動素子が形成された基板の表面を平坦化し、有機発光素子の各層の膜厚を均一に形成することができるようにするためのものであり、通常は、表示領域のみに形成される(例えば、特許文献 1 参照。)。ただし、平坦化層を表示領域外部、基板の背面の周縁部に保護筐体を接着するためのシールの下まで延在させ、平坦化層をシール硬化時のストレスを吸収する緩衝層として利用するようにした構成もある(例えば、特許文献 2 参照)。

$[0\ 0\ 0\ 4]$

また、平坦化層の材料については、例えば、有機発光素子への水分の進入を阻止するため、SOG(Spin On Glass)材料など水分を蒸発させる温度に耐えうる膜を採用するようにした提案がある(例えば、特許文献3参照。)。あるいは、エポキシ基を含有するアルカリ可溶性樹脂と1,2ーキノンジアジド化合物とを含有する材料を採用することにより、スルーホール等を高解像度で形成できることが報告されている(例えば、特許文献4参照。)。

[0005]

【特許文献1】

特開2001-102168号公報

【特許文献2】

特開2001-102166号公報

【特許文献3】

特開2001-102165号公報

【特許文献4】

特開2002-182380号公報

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

近年では、高輝度・高開口度の有機発光ディスプレイとして、基板と封止基板とを接着層を介して全面にわたって貼り合わせ、有機発光素子により発生した光を封止基板の側から取り出すようにした上面発光・完全固体封止構造が提案されている。しかしながら、このような構造では、平坦化層をパターニングすることなく基板の全面にわたって形成していたので、接着層の端部から平坦化層の端部が露出した状態となっていた。そのため、外部の水分が平坦化層を経路として侵入し、有機発光素子の劣化の原因となるおそれがあった。

$[0\ 0\ 0\ 7\]$

本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、平坦化層を経由 して水分が侵入するのを防止することができ、信頼性を高めた表示装置およびそ の製造方法を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】

本発明による表示装置は、基板と、この基板に設けられた駆動素子層と、この 駆動素子層を覆う平坦化層と、この平坦化層の前記基板と反対側に設けられた複数の発光素子と、この複数の発光素子を覆うと共に前記平坦化層の表面および端面を覆う中間層と、この中間層を介して前記基板の前記発光素子側に対向配置された封止基板とを備えたものである。

[0009]

本発明による表示装置の製造方法は、基板に駆動素子層を形成する工程と、駆動素子層を覆う平坦化層を形成する工程と、平坦化層の上に複数の発光素子を形成する工程と、発光素子ならびに平坦化層の表面および端面を覆う中間層を形成する工程と、中間層の上に封止基板を配設する工程とを含むものである。

[0010]

本発明による表示装置では、中間層が平坦化層の表面だけでなく端面をも覆っているので、平坦化層の端面が基板と封止基板との間から外部に露出せず、外部の水分が平坦化層を経路として発光素子部分へ侵入することがない。

[0011]

本発明による表示装置の製造方法では、基板に駆動素子層が形成され、この駆動素子層を覆う平坦化層が形成される。続いて、平坦化層の上に複数の発光素子が形成されたのち、中間層が、発光素子ならびに平坦化層の表面および端面を覆うように形成される。そののち、中間層の上に封止基板が配設される。

[0012]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。

[0013]

図1は、本発明の一実施の形態に係る表示装置の概略構造を表し、図2は図1に示した表示装置のII-II線における断面構造を表すものである。この表示装置は、例えば極薄型の有機発光ディスプレイとして用いられるものであり、基板10と封止基板20とが対向配置されている。基板10と封止基板20との間の空間は、中間層30により完全に充填されている。

$[0\ 0\ 1\ 4]$

基板10は、例えば、ガラスなどの絶縁材料により構成されている。基板10の一辺は、図1に示したように、封止基板20および中間層30により覆われておらず、露出している。この露出した部分には、例えばチタン(Ti)一アルミニウム(A1)よりなる端子部10Aが設けられている。

[0015]

基板10の中央付近は、図2(A)に示したように、赤色の光を発生する有機発光素子10Rと、緑色の光を発生する有機発光素子10Gと、青色の光を発生する有機発光素子10Bとが、順に全体としてマトリクス状に設けられた表示エリア11となっている。表示エリア11には、有機発光素子10R,10G,10Bを駆動するための駆動素子層40が形成されている。この駆動素子層40は

、平坦化層50により覆われており、平坦化層50の上に有機発光素子10R, 10G, 10Bが形成されている。

[0016]

基板10の周辺部分は、図2(B)に示したように、有機発光素子10R,10G,10Bに外部の水分が侵入しないように中間層30により封止するための封止エリア12となっている。封止エリア12には周辺回路部60が設けられている。

[0017]

有機発光素子10R,10G,10Bは、例えば、基板10の側から、陽極としての第1電極13、絶縁層14、発光層を含む有機層15、および陰極としての第2電極16がこの順に積層されている。第2電極16は、有機発光素子10R,10G,10Bのすべてを覆うように形成され、有機発光素子10R,10G,10Bの共通電極となっている。封止エリア12内、および表示エリア11内の絶縁膜14の上には、第2電極16の電圧降下を抑制するための補助電極16A,16Bがそれぞれ設けられている。

[0018]

第1電極13は、反射層としての機能も兼ねており、例えば、白金(Pt),金(Au),クロム(Cr)またはタングステン(W)などの金属または合金により構成されている。

[0019]

絶縁層14は、第1電極13と第2電極16との絶縁性を確保すると共に、有機発光素子10R,10G,10Bにおける発光領域の形状を正確に所望の形状とするためのものである。この絶縁層14は、例えば、二酸化ケイ素(SiO2)などの絶縁材料により構成されている。

[0020]

有機層15は、有機発光素子の発光色によって構成が異なっている。有機発光素子10R,10Bは、正孔輸送層,発光層および電子輸送層が第1電極13の側からこの順に積層された構造を有しており、有機発光素子10Gは、正孔輸送層および発光層が第1電極13の側からこの順に積層された構造を有している。

正孔輸送層は、発光層への正孔注入効率を高めるためのものである。発光層は、電界をかけることにより電子と正孔との再結合が起こり、光を発生するものである。電子輸送層は、発光層への電子注入効率を高めるためのものである。

[0021]

有機発光素子10Rの正孔輸送層の構成材料としては、例えば、ビス [(Nーナフチル)-N-フェニル] ベンジジン(α -NPD)が挙げられ、有機発光素子10Rの発光層の構成材料としては、例えば、2, 5-ビス [4-[N-(4-メトキシフェニル)-N-フェニルアミノ]] スチリルベンゼン-1, 4-ジカーボニトリル(BSB)が挙げられ、有機発光素子10Rの電子輸送層の構成材料としては、例えば、8-キノリノールアルミニウム錯体(A1q3) が挙げられる。

[0022]

有機発光素子10Bの正孔輸送層の構成材料としては、例えば、 $\alpha-NPD$ が挙げられ、有機発光素子10Bの発光層の構成材料としては、例えば、4, 4-ビス(2, 2-ジフェニルビニン)ビフェニル(DPVBi)が挙げられ、有機発光素子10Bの電子輸送層の構成材料としては、例えば、 Alq_3 が挙げられる。

[0023]

有機発光素子10 Gの正孔輸送層の構成材料としては、例えば、 $\alpha-NPD$ が挙げられ、有機発光素子10 Gの発光層の構成材料としては、例えば、A1 q_3 にクマリン6 (C6; Coumarin6) を1 体積%混合したものが挙げられる。

[0024]

第2電極16は、半透過性電極により構成されており、発光層で発生した光は 第2電極16の側から取り出されるようになっている。第2電極16は、例えば 、銀(Ag),アルミニウム(Al),マグネシウム(Mg),カルシウム(C a),ナトリウム(Na)などの金属または合金により構成されている。

[0025]

補助電極16Aは、例えば、封止エリア12において、表示エリア11を取り 囲むように形成されている。補助電極16Bは、例えば、表示エリア11におい て、絶縁膜14の上に行列状に形成されており、補助電極16Aに接続されている。封止エリア12内に形成される補助電極16Aは、表示エリア11内に形成される補助電極16Bよりも膜厚を厚く、幅も広くすることが可能である。補助電極16A,16Bは、例えば、アルミニウム(A1)あるいはクロム(Cr)のような低抵抗の導電性材料を単層あるいは積層構造としたものにより構成されている。

[0026]

封止基板20は、基板10の有機発光素子10R,10G,10Bの側に位置しており、中間層30と共に有機発光素子10R,10G,10Bを封止している。この封止基板20は、有機発光素子10R,10G,10Bで発生した光に対して透明なガラスなどの材料により構成されている。封止基板20には、例えば、図示しないカラーフィルターを設け、有機発光素子10R,10G,10B並びにその間の配線において反射された外光を吸収し、コントラストを改善するようにしてもよい。

[0027]

中間層30は、有機発光素子10R,10G,10Bを覆うと共に、平坦化層50の表面50Aおよび端面50Bを覆っている。本実施の形態では、中間層30は封止基板20の全面に形成されており、平坦化層50の形成範囲は、中間層30の形成された領域よりも内側の領域(図1の斜線を施した領域)となっている。

[0028]

中間層30は、例えば、有機発光素子10R,10G,10Bならびに平坦化層50の表面50Aおよび端面50Bを覆う保護膜31と、この保護膜31と封止基板20との間に設けられた接着層32とを有していることが好ましい。保護膜31を設けることにより、有機発光素子10R,10G,10Bを保護し、その劣化を効果的に防止することができるからである。また、保護膜31は、ガラスよりなる基板10よりも接着層32との密着性が良く、接着層32のある部分には保護膜31が形成されていることが望ましいからである。保護膜31は、例

えば、酸化シリコン(SiO_2),窒化シリコン(SiN)などの透明誘電体により構成されている。接着層 32 は、例えば、熱硬化性樹脂により構成され、基板 10 と封止基板 20 とを全面にわたって貼り合わせるものである。

[0029]

駆動素子層40は、有機発光素子10R,10G,10Bを駆動する駆動素子としてTFT41を含んでいる。TFT41のゲート電極(図示せず)は、図示しない走査回路に接続され、ソースおよびドレイン(いずれも図示せず)は、例えば酸化シリコンあるいはPSG(Phos-Silicate Glass)などよりなる層間絶縁膜42を介して設けられた配線43に接続されている。配線43は、層間絶縁膜42に設けられた図示しない接続孔を介してTFT41のソースおよびドレインに接続され、信号線として用いられる。配線43は、例えばアルミニウム(A1)もしくはアルミニウム(A1)一銅(Cu)合金により構成されている。なお、TFT41の構成は、特に限定されず、例えば、ボトムゲート型でもよい。

[0030]

平坦化層 5 0 は、駆動素子層 4 0 が形成された基板 1 0 の表面を平坦化し、有機発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 B の各層の膜厚を均一に形成することができるようにするためのものである。平坦化層 5 0 には、有機発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 B の第 1 電極 1 3 と配線 4 3 とを接続する接続孔 5 1 が設けられている。

[0031]

平坦化層 5 0 は、微細な接続孔 5 1 が形成されるため、パターン精度が良い材料により構成されていることが好ましい。更に、表示エリア 1 1 においては平坦化層 5 0 の上に有機発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bが形成されるので、有機発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bが形成されるので、有機発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bの劣化を防ぐため、吸水率の低い材料により構成されていればより好ましい。吸水率は、例えば、所定の測定条件下で約 1 %以下であることが好ましい。本実施の形態では、平坦化層 5 0 は、例えばポリイミド等の有機材料により構成されている。

[0032]

また、平坦化層50は、駆動素子層40に限らず、およそ電極あるいは回路が

設けられる部分にはすべて設けられていることが好ましい。例えば、平坦化層 5 0は、表示エリア 1 1内の駆動素子層 4 0を覆うだけでなく、封止エリア 1 2 にも延在し、周辺回路部 6 0を覆うように形成されていることが好ましい。周辺回路部 6 0を、有機発光素子 1 0 R, 1 0 G, 1 0 Bを形成するプロセスから保護することができるからである。また、例えば、補助電極 1 6 A は、平坦化層 5 0の上に形成してもよく、あるいは、コンタクトホールによる接続手法を用いて平坦化層 5 0 の下に形成してもよいが、平坦化層 5 0 の下に形成される場合には、平坦化層 5 0 は、補助電極 1 6 A を覆うように形成されることが好ましい。

[0033]

この表示装置では、例えば、第1電極13と第2電極16との間に所定の電圧が印加されると、有機層15の発光層に電流が注入され、正孔と電子とが再結合することにより発光が起こる。この光は、封止基板20の側から取り出される。ここで、本実施の形態では、中間層30、すなわち、保護膜31および接着層32によって平坦化層50の表面50Aだけでなく、その端面50Bが覆われている。従って、平坦化層50の端面50Bが基板10と封止基板20との間から外部に露出せず、外部の水分が平坦化層50を経路として内部に侵入することが防止され、有機発光素子10R,10G,10Bの劣化が防止される。

[0034]

この表示装置は、例えば、次のようにして製造することができる。

[0035]

図3ないし図6はこの表示装置の製造方法を工程順に表すものである。まず、図3に示したように、例えば、上述した材料よりなる基板10に、駆動素子層40を構成するTFT41,層間絶縁膜42および配線43と、周辺回路部60とを形成する。

[0036]

次に、図4に示したように、基板10の全面に、感光性を有する材料、例えば 平坦化層50の材料として上述した材料よりなる感光性膜52を形成する。

[0037]

続いて、図5に示したように、感光性膜52の露光および現像により、駆動素

子層 4 0 および周辺回路部 6 0 を覆うように平坦化層 5 0 を形成する。同時に接続孔 5 1 も形成することが可能である。

[0038]

そののち、図6に示したように、有機発光素子10R,10G,10Bおよび端子部10A(図1参照)を形成する。すなわち、平坦化層50の接続孔51に対応して、上述した材料よりなる第1電極13を形成し、駆動素子層40と第1電極13との電気的導通をとる。次に、この第1電極13の上に、絶縁膜14を所定のパターンで形成する。続いて、絶縁膜14の上に補助電極16Bを形成すると共に、封止エリア12には補助電極16Aを形成する。次に、上述した材料よりなる正孔注入層,正孔輸送層,発光層および電子輸送層を順次成膜して有機層15を形成したのち、上述した材料よりなる第2電極16を形成する。

[0039]

有機発光素子10R,10Gを形成したのち、図7に示したように、保護膜31を、有機発光素子10R,10G,10Bならびに平坦化層50の表面50Aおよび端面50Bを覆うように形成する。続いて、上述した材料よりなる接着層32を形成する。これにより、中間層30が形成される。

[0040]

次に、上述した材料よりなり、必要に応じてカラーフィルターなどを形成した 封止基板20を用意し、基板10と封止基板20とを接着層32を介して全面に わたって貼り合わせる。以上により、図1および図2に示した表示装置が完成す る。

[0041]

また、この表示装置は、例えば、次のようにして製造することもできる。

[0042]

まず、図3に示したように、上述した方法と同様にして、基板10に、駆動素 子層40および周辺回路部60を形成する。

[0043]

次に、図8に示したように、平坦化層50が形成される領域(図1の斜線を施 した領域)と同等のサイズを有するシート状平坦化膜53を形成する。このシー ト状平坦化膜53を、駆動素子層40が形成された基板10の所定の位置に配置する。これにより、図9に示したように、平坦化層50を形成する。

[0044]

そののち、平坦化層50に接続孔51を形成し、上述した方法と同様にして、有機発光素子10R,10G,10Bおよび端子部10Aを形成する。続いて、保護膜31で有機発光素子10R,10G,10Bならびに平坦化膜50の表面50Aおよび端面50Bを覆い、接着層32を介して基板10と封止基板20とを全面にわたって貼り合わせる。以上により、図1に示した表示装置が完成する

[0045]

以上の本実施の形態では、基板10と封止基板20との間の中間層30が、有機発光素子10R,10G,10Bおよび平坦化層50の表面50Aだけでなく、更に、平坦化層50の端面50Bをも覆うように構成したので、平坦化層50の端面50Bが基板10と封止基板20との間から外部に露出することがなくなる。従って、外部の水分が平坦化層50を経路として内部に侵入し、有機発光素子10R,10G,10Bを劣化させることがなくなり、これにより表示装置の信頼性が向上する。

[0046]

特に、本実施の形態では、保護膜31により有機発光素子10R,10G,10Bならびに平坦化層50の表面50Aおよび端面50Bを覆い、かつこの保護膜31と封止基板20との間に接着層32を介在させるようにしたので、保護膜31および接着層32によって有機発光素子10R,10G,10Bの劣化を効果的に防止できると共に、保護膜31と接着層32との密着性を高めることができる。よって、封止性能を向上させることができ、特に、基板10と封止基板20とが接着層32を介して全面にわたって貼り合わせられた完全固体封止構造の表示装置に好適である。

[0047]

以上、実施の形態を挙げて本発明を説明したが、本発明は上記実施の形態に限 定されるものではなく、種々変形が可能である。例えば、図10に示したように 、中間層30を、接着層32のみの構成としてもよい。

[0048]

また、例えば、上記実施の形態において説明した各層の材料および厚み、または成膜方法および成膜条件などは限定されるものではなく、他の材料および厚みとしてもよく、または他の成膜方法および成膜条件としてもよい。例えば、上記実施の形態においては、基板10に、第1電極13,有機層15および第2電極16を基板10の側から順で積層し、封止基板20の側から光を取り出すようにした場合について説明したが、積層順序を逆にして、基板10の上に、第2電極16,有機層15および第1電極13を基板10の側から順に積層し、基板10の側から光を取り出すようにすることもできる。

[0049]

更に、例えば、上記実施の形態では、第1電極13を陽極、第2電極16を陰極とする場合について説明したが、陽極および陰極を逆にして、第1電極13を陰極、第2電極16を陽極としてもよい。さらに、第1電極13を陰極、第2電極16を陽極とすると共に、基板10の上に、第2電極16,有機層15および第1電極13を基板10の側から順に積層し、基板10の側から光を取り出すようにすることもできる。

[0050]

加えて、上記実施の形態では、有機発光素子10R,10G,10Bの構成を 具体的に挙げて説明したが、全ての層を備える必要はなく、また、他の層を更に 備えていてもよい。

[0 0 5 1]

更にまた、上記実施の形態では、第2電極16が半透過性反射層により構成され、第2電極16の電圧降下を抑制するための補助電極16A,16Bを備えている場合について説明したが、第2電極16は、半透過性反射層と透明電極とが第1電極13の側から順に積層された構造としてもよい。この透明電極は、半透過性反射層の電気抵抗を下げるためのものであり、発光層で発生した光に対して十分な透光性を有する導電性材料により構成されている。透明電極を構成する材料としては、例えば、ITOまたはインジウムと亜鉛(Zn)と酸素とを含む化

合物が好ましい。室温で成膜しても良好な導電性を得ることができるからである。

[0052]

加えてまた、上記実施の形態では、基板10と封止基板20とが接着層32を 介して全面にわたって貼り合わせられている場合について説明したが、本発明は 、例えば、基板10の周縁部のみに接着層32を形成して金属缶などを接着する ようにした場合など、接着層32が基板10と封止基板20との間の一部分のみ に形成された場合についても適用することができる。

[0053]

【発明の効果】

以上説明したように本発明の表示装置およびその製造方法によれば、基板と封止基板との間の中間層が平坦化層の表面だけでなく端面をも覆うように構成したので、平坦化層の端面が基板と封止基板との間から外部に露出することがなく、外部の水分が平坦化層を経路として内部の素子部分に侵入することがなくなる。よって、素子が劣化することがなくなり、表示装置の信頼性が高まる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の一実施の形態に係る表示装置の概略構成を表す平面図である。

図2

図1に示した表示装置の I I - I I 線に沿った断面構造を表す断面図である。

【図3】

図1に示した表示装置の製造工程を説明するための断面図である。

【図4】

図3の工程に続く製造工程を説明するための図である。

図5】

図4の工程に続く製造工程を説明するための図である。

【図6】

図5の工程に続く製造工程を説明するための図である。

【図7】

ページ: 15/E

図6の工程に続く製造工程を説明するための図である。

【図8】

図1に示した表示装置の他の製造方法を説明するための図である。

【図9】

図8の工程に続く製造工程を説明するための図である。

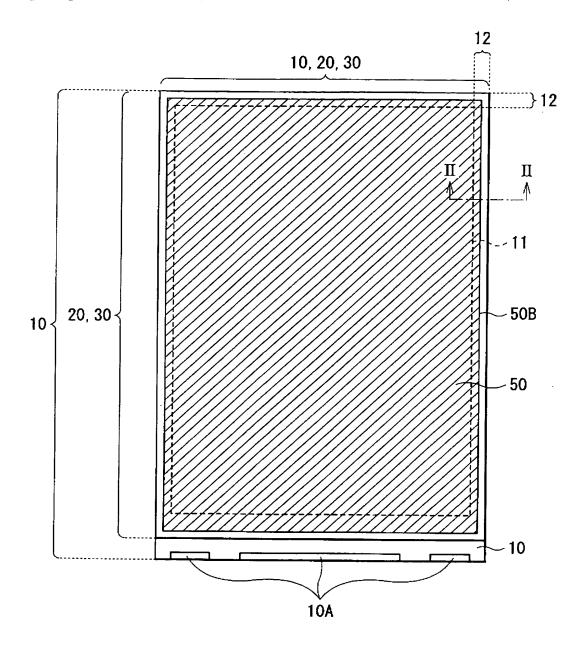
【図10】

図1に示した表示装置の変形例を表す断面図である。

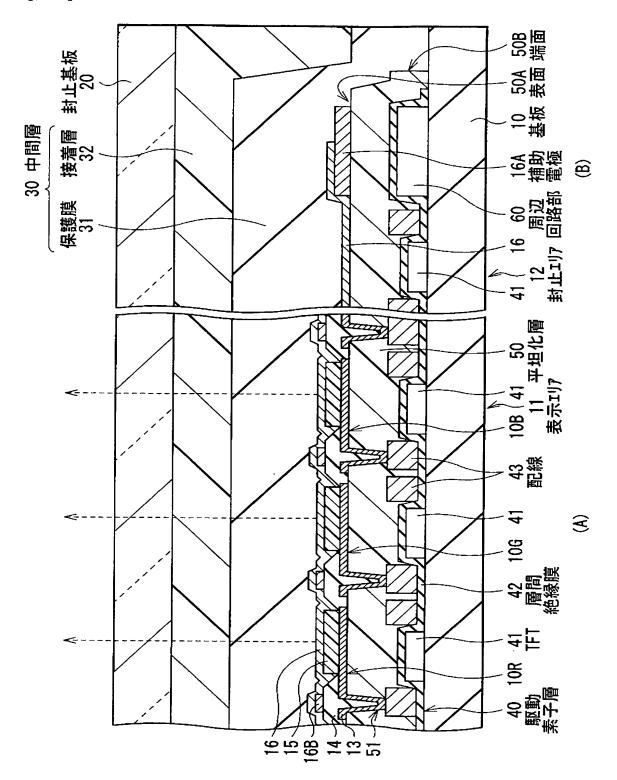
【符号の説明】

10…基板、10A…端子部、11…表示エリア、12…封止エリア、13… 第1電極、14…絶縁膜、15…有機層、16…第2電極、16A, 16B…補 助電極、20…封止基板、30…中間層、31…保護膜、32…接着層、40… 駆動素子層、41…TFT、42…層間絶縁膜、43…配線、50…平坦化層、 50A…表面、50B…端面、51…接続孔、60…周辺回路部 【書類名】 図面

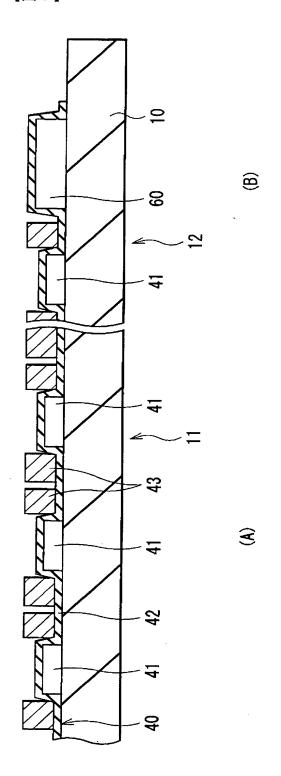
【図1】



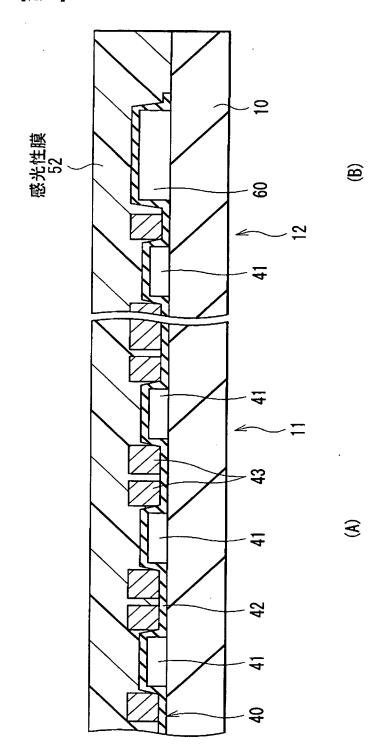
【図2】



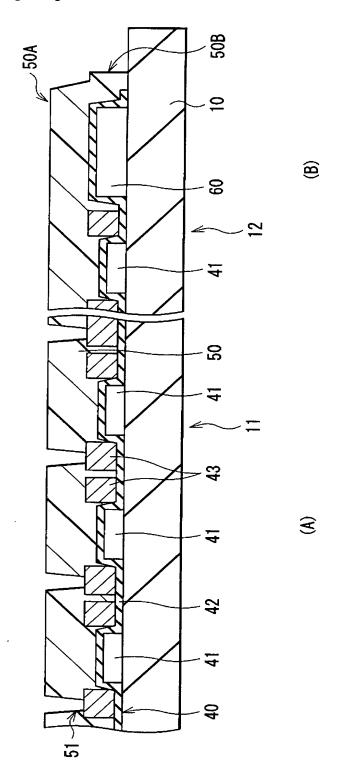
【図3】



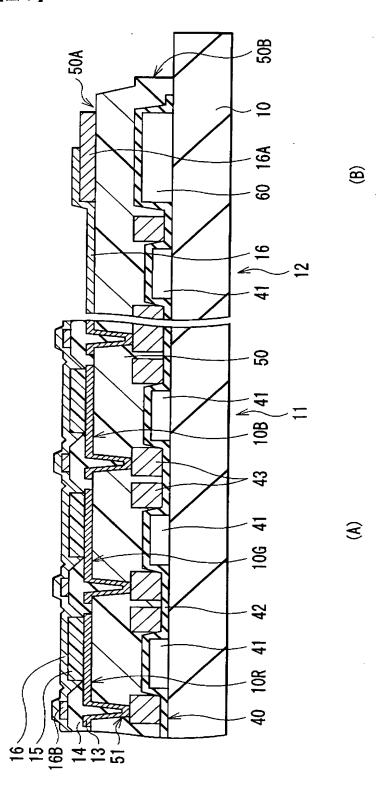
【図4】



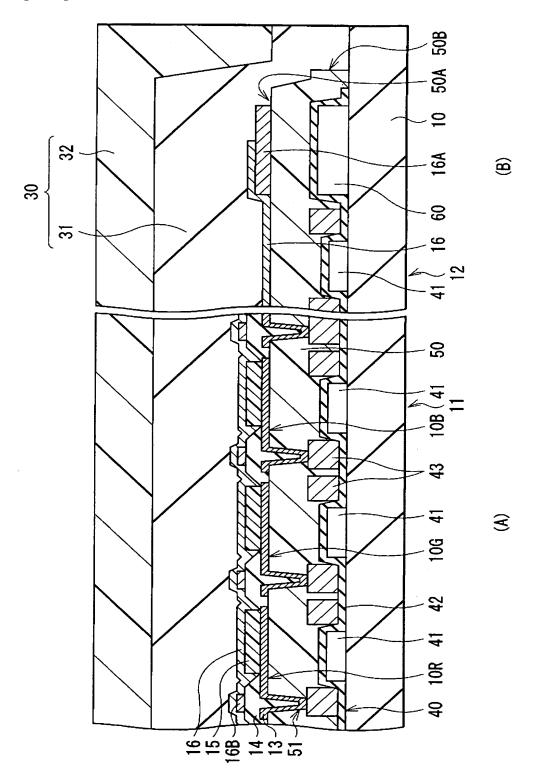
【図5】



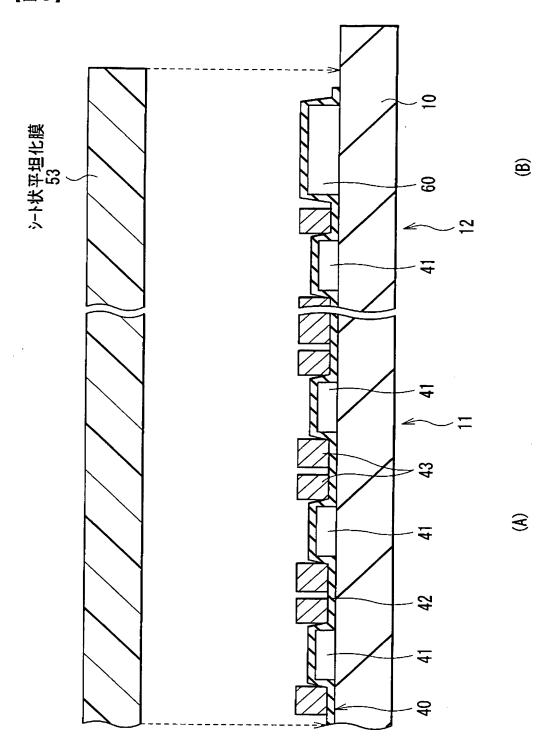
【図6】



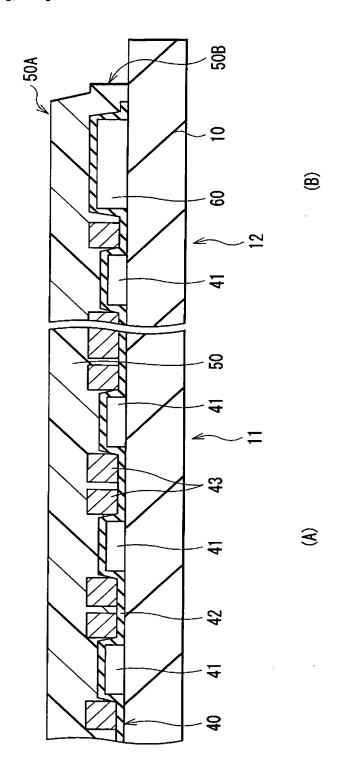
【図7】



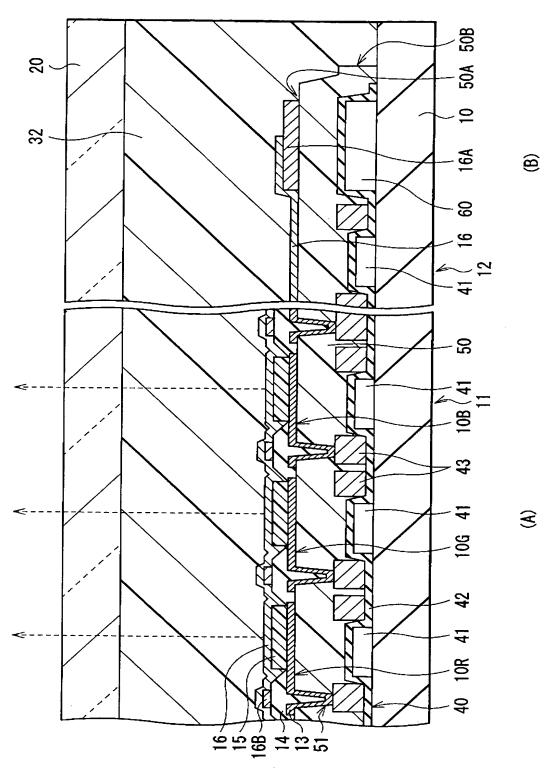
【図8】



【図9】







【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 平坦化層を経由して水分が侵入するのを防止することができ、信頼性 を高めた表示装置を提供する。

【解決手段】 基板10と封止基板20とが、中間層30を介して対向配置されている。基板10には、TFT41を含む駆動素子層40が形成されている。駆動素子層40は、平坦化層50で覆われ、平坦化層50の上に、有機発光素子10R,10G,10Bが形成されている。中間層30は、平坦化層50の表面50Aだけでなく端面50Bをも覆うように設けられている。平坦化層50の端面50Bが基板10と封止基板20との間から露出せず、外部の水分が平坦化層50を経路として侵入することがない。

【選択図】

図 2

特願2003-046318

出願人履歴情報

識別番号

[000002185]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川6丁目7番35号

氏 名 ソニー株式会社